

承 认 书

客户名称：_____

物料编码：_____

产品型号：JK-020白光6000-7000k

版本编号：1.20

日 期：2022-03-25

产品描述：

- 贴片020白光
- 胶体颜色：黄色



承 认 签 章		
编制	审核	核准

客 户 确 认		
确认	审核	核准

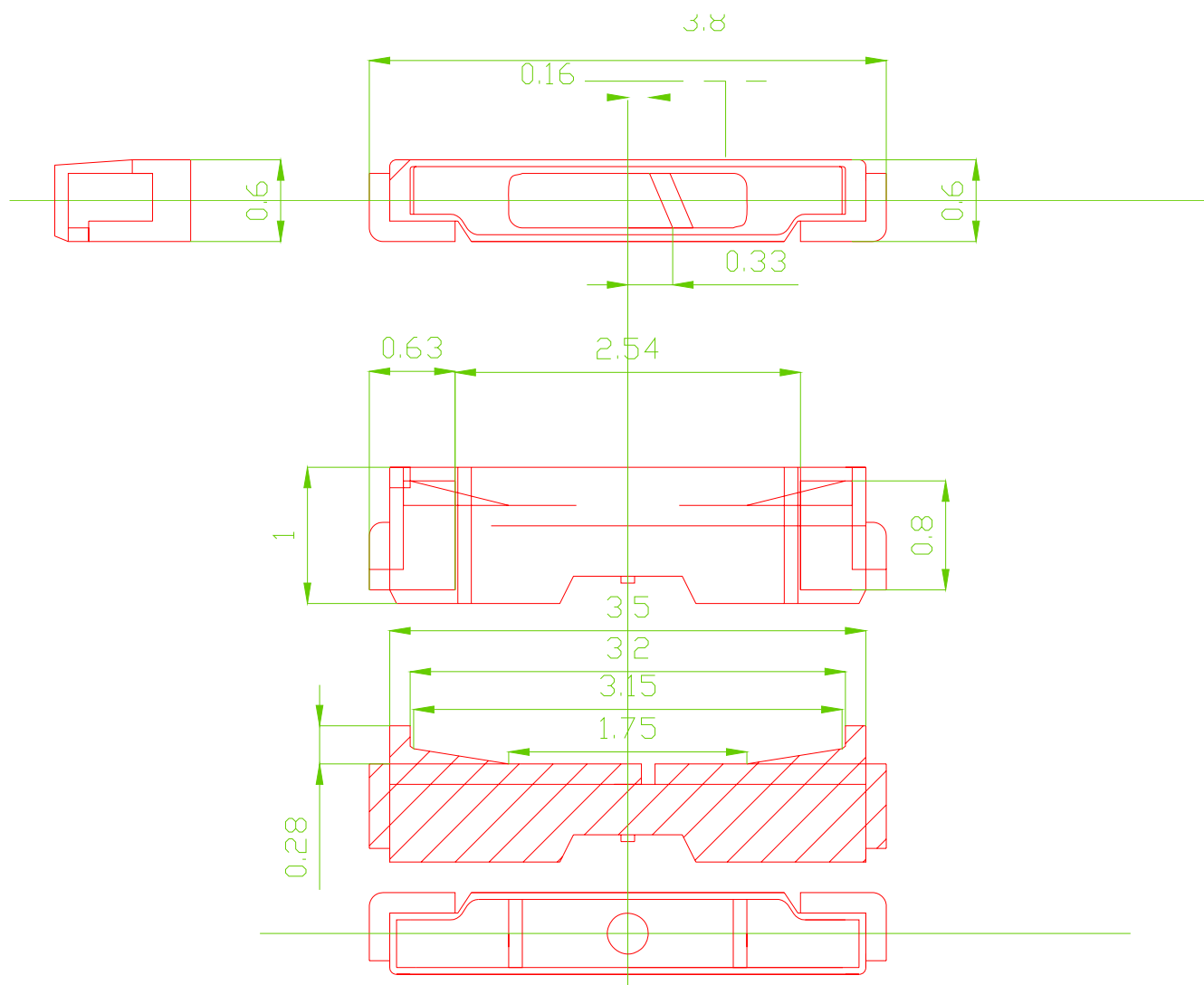
特性:

- 1.1 封装尺寸: 3.8x1.0x0.6mm
- 1.2 发光颜色: 白色
- 1.3 发光类型: 单色型
- 1.4 焊接方式: 回流焊
- 1.5 符合RoHS 标准

应用范围:

- 2.1 手机、MP3、MP4车载及家用电器等背光模组
- 2.2 一般应用

外形尺寸 **Dimensions** 单位(Units):毫米(mm)



注意:

所有尺寸单位为 mm , 如无特殊说明误差范围为 ± 0.1 mm
All dimensions are in mm tolerance is ± 0.1 mm unless otherwise noted.

光电特性 Electrical / Optical characteristics
(1) 最大限度值 Absolute Maximum Ratings (TA=25±5°C)

项目 Item	符号 Symbol	最大额定值 Absolute Maximum Rating	单位 Unit
正向电流 Forward Current	IF	20	mA
反向电压 Reverse Voltage	VR	5	V
功率消耗 Power Dissipation	PD	68	mW
工作温度 Operating Temperature	Topr	-40°C To +85°C	°C
贮藏温度 Storage Temperature	Tstg	-40°C To +85°C	°C
焊接温度 Soldering Temperature	Tsld	Reflow Soldering: 260°C Hand Soldering : 300°C	for 10sec. for 3sec.

1/10周期, 0.1 msec脉宽

IFP Conditions : 1/10 Duty Cycle, 0.1 msec Pulse Width.

(2) 样品光电参数 Initial Electrical/Optical Characteristics (TA=25±5°C)

符号 Symbol	项目 Item	单位 Units	最小值 Min.0	规格值 Typ.	最大值 Max.	测试条件 Test Conditions
VF	正向电压 Forward Voltage	V	2.9	-	3.1	IF=20mA
2θ ½	发光角度 Viewing Angle	°	-	120°	-	
∅	亮度 Luminous flux	IV	3200	-	3300	
TC	色温 Colour Temperature	k	6000	-	7000	
RA	显色指数 Color Rendering Index	Ra	-	70	-	
	色坐标 Color coordinates	X Y	- -	0.28 0.29	- -	
IR	反向电流 Reverse Current	uA	-	-	1	VR=5V

备注: Remark:

色座标 (IF=20mA, Ta=25°C)

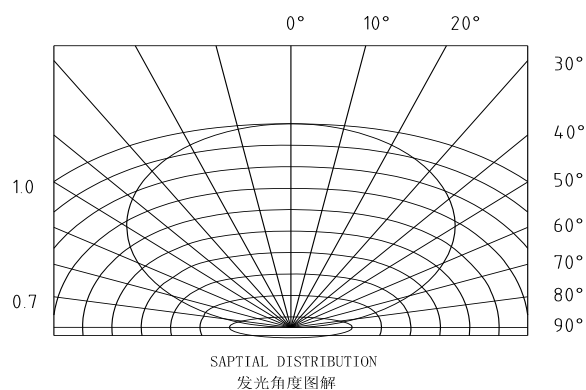
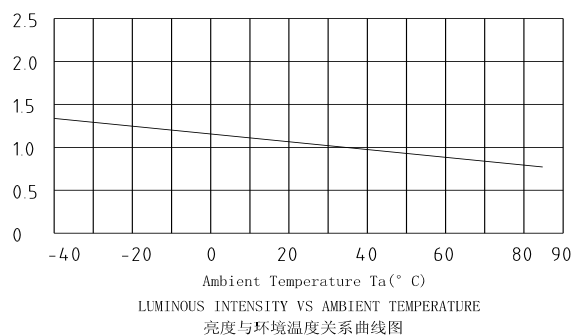
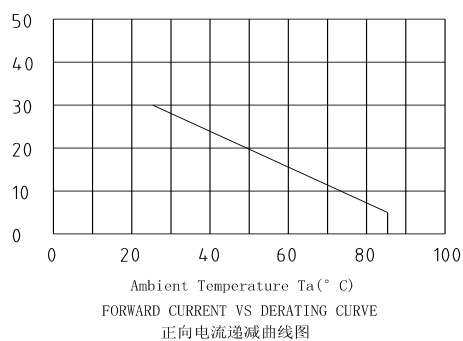
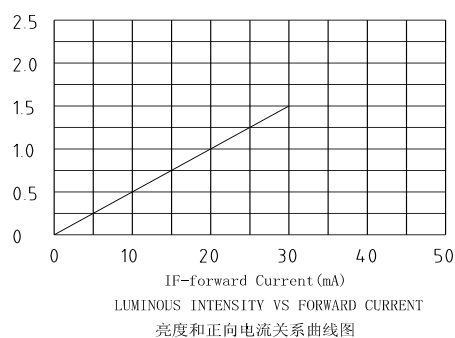
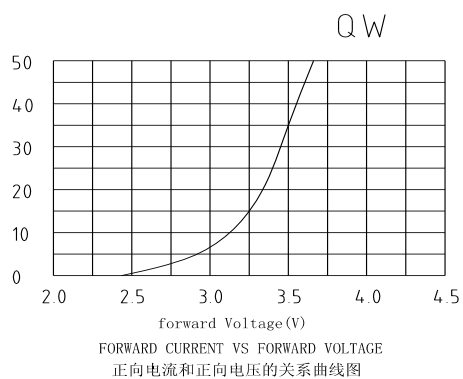
正向电压允许误差± 0.05V Tolerance of measurement of Vf is ±0.05 V..

光通量允许误差±0.2lm Luminous Intensity Measurement allowance is ±0.2lm

色温误差范围±100k Colour Temperature Measurement allowance is ±100k

显色指数允许误差±1 Color Rendering Index Measurement allowance is ±1.

特性曲线 Characteristic curve



可靠性 RELIABILITY

(1) 测试项目及结果 Test Items and Results

序号	试验项目	参考标准	试验条件	持续时间	取样数	接收水准 (不合格数量/抽样总数)
1	温度循环		-40℃~25℃~100℃~ 25℃ 30分钟 5分钟 30分钟 5分钟	循环 100 回合	50	0/50
2	冷热冲击		-40℃~100℃ 15分钟 15分钟	循环 500 回合	50	0/50
3	高温储存		T _a =100℃	1000 小时	50	0/50
4	低温储存		T _a =-40℃	1000 小时	50	0/50
5	常温寿命 试验		T _a =25±5℃ IF=20mA	1000 小时	50	0/50
6	高温高湿 寿命试验		T _a =60℃ RH=85% IF=20mA	1000 小时	50	0/50
7	可焊性 (回流 焊)		T _{so1} =235℃±5℃, 5 秒 使用助焊剂	焊接一次, 5 秒	10	0/10
8	耐焊性 (回流焊)		T _{so1} =260℃, 10 秒 预处理: 35℃ 95%RH 96 小时	焊接二次, 每 次 10 秒	10	0/10
备注	以上试验项目如与客户试验要求存在差异的或者特殊客户特殊要求的可根据实际情况按照客户的要求进行试作, 客户未要求的按我司试验标准试作. 不同产品使用不同电流进行测试					

注意事项 Cautions

(1) 焊接条件 Soldering Conditions

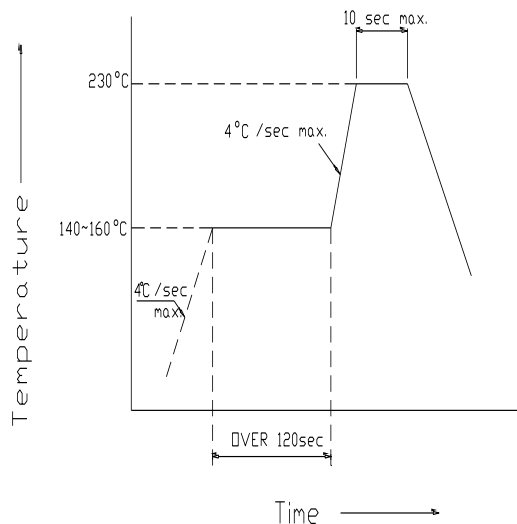
本产品最多只可回焊两次,且在首次回焊后须冷却至室温之后方可进行第二次回焊.

Number of reflow process shall be less than 2 times and cooling process to normal temperature is required between first and Second soldering process.

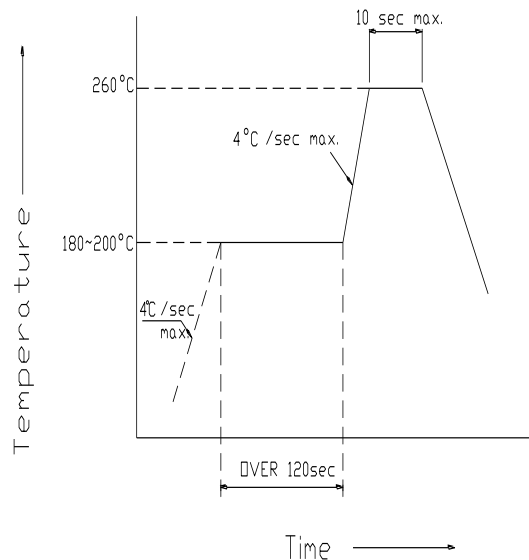
推荐焊接条件(Recommended soldering conditions)

	回流焊接 Reflow Soldering		手工焊接 Hand Soldering	
	有铅Lead Solder	无铅 Lead-free Solder	温度Temperature	350 °C Max.
预热温度Pre-heat	140 ~ 160 °C	180 ~ 200 °C	焊接时间Soldering time	3 sec. Max.
预热时间Pre-heat time	120 sec. Max.	120 sec. Max.		(one time only)
峰值温度Peak temperature	230 °C Max.	260 °C Max.		
焊接时间Soldering time	10 sec. Max.	10 sec. Max.		
条件Condition	参考下图	参考下图		

有铅回焊 (Lead Solder)



无铅回焊 (Lead-Free Solder)



(2) 静电 Static Electricity

触摸 LED 时,推荐使用防静电手腕带或防静电手套.

It is recommended that a wrist band or an anti-electrostatic glove be used when handling the LEDs.

所有装置、设备、机器均应接地.

All devices, equipment and machinery must be properly grounded.

静电损坏的 LED 会显示出异常特征:正向电压变低或在低电流时死灯.标准: $I_F=0.5mA$ 时, $V_F > 2.0V$

Damaged LEDs will show some unusual characteristics such as the forward voltage becomes lower, or the LEDs do not light at the low current. Criteria : ($V_F > 2.0V$ at $I_F=0.5mA$)

(3) 防潮包装 Moisture Proof Package

使用防潮包装

It is recommended that moisture proof package be used .

(4) 储藏 Storage

打开包装袋之前,LED 在温度为 30 °C 或更低湿度 70%RH 以下,可保存一年.

Before opening the package ,The LEDs should be kept at 30 °C or less and 70%RH or less. The LEDs should be used within a year.

(5) 打开包装之后,应在 24hrs 内焊接完毕.

After opening the package, The LEDs should be soldered within 24 hours (1days) after opening the package.

(6)使用注意事项

Cautions:

6.1. 在开包装之前, 请先检查包装袋有无漏气, 如果有漏气现象, 请退回我司重新烘烤除湿包装后再使用。
Please check if there is air leak before opening the package, if so, please return the goods back to take drying process for later using.

6.2 抽真空包装材料未超过 15 天可正常使用, 包装袋开启后, 产品必须:
Products can be used within 15days after packaging, after that, they must be:

6.2.1 在 24hrs 内未焊接完毕。

Soldered within 24 hrs

6.2.2 要在规定环境条件中使用: 温度:30℃以内 湿度:60%RH 以下

Used in the condition: 30℃ within and 60%RH below

6.2.3 存储低于 30%RH。

Stored in 30%RH for moisture below.

6.3. 抽真空包装材料超过 30 天(含)以上未使用, 再使用时需重新拆铝箔袋取出烘烤 85℃/12H 除湿后才可使用。

Products cannot be used for and over 30days after being packaged unless opening the package and take drying our process in 85℃/12H.

6.4. 抽真空包装材料超过 60 天(含)以上未使用, 请退回我司重新烘烤除湿包装后再使用。

Products not be used for or over 60days after being packaged please return back to take drying out and packaging process for forward using.

6.5. 材料拆装后使用时间超过 24H 未用完, 需烘烤 65℃/8H 除湿后才可使用。

Products not be used after opening the package need to be dried out for 65℃/8H

其他事项 Others

直接用手拿取产品不仅会污染封装树脂表面, 而且还可能影响其光学特性。过度的压力也可能直接影响封装内部的芯片和导线, 因此请勿对产品施加过度压力, 特别是在产品处于高温状态下, 例如在回流焊接过程中。LED 的封装胶体部分相当脆弱, 请勿用坚硬、尖锐的物体刮、擦封装树脂部分, 在用镊子夹取 LED 的时候也应当小心注意。

When handling the product, touching the encapsulant with hands will not only contaminate its surface, but also affect its optical characteristics. Excessive force to the encapsulant might result in catastrophic failure of the LEDs due to die breakage or wire deformation. For this reason, please do not put excessive stress on LEDs, especially when the LEDs are heated such as during Reflow Soldering. The resin of encapsulant is fragile, so please avoid scratch or friction over the resin.